

2022-2027年中国LED用衬底材料行业发展监测及 投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2022-2027年中国LED用衬底材料行业发展监测及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/electric/817859.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2017-2021年半导体照明（LED）产业总体分析

1.1 2017-2021年全球LED产业总体发展

1.1.1 产业发展现状

1.1.2 重点区域市场

1.1.3 企业竞争格局

1.1.4 专利技术现状

1.1.5 照明市场前景

1.2 2017-2021年中国LED产业发展现状

1.2.1 行业发展现状

1.2.2 市场发展特点

1.2.3 产量规模分析

1.2.4 技术前沿热点

1.2.5 技术发展趋势

1.3 2017-2021年中国LED市场发展现状

1.3.1 主要应用需求

1.3.2 出口情况分析

1.3.3 产业集群现状

1.3.4 企业购并整合

1.4 2017-2021年中国LED产业链发展分析

1.4.1 产业链组成环节

1.4.2 产业链发展透析

1.4.3 产业链主要壁垒

1.4.4 产业链发展趋势

第二章 2017-2021年LED用衬底材料发展综述

2.1 LED衬底材料的基本情况

2.1.1 LED外延片基本概述

2.1.2 红黄光LED衬底

2.1.3 蓝绿光LED衬底

2.2 LED用衬底材料总体发展状况

2.2.1全球LED材料市场

2.2.2中国市场发展现状

2.2.3技术发展现状分析

2.2.4衬底材料发展趋势

第三章 2017-2021年蓝宝石衬底发展分析

3.1蓝宝石衬底的基本情况

3.1.1蓝宝石衬底材料的特征

3.1.2外延片蓝宝石衬底要求

3.1.3蓝宝石生产设备的情况

3.1.4蓝宝石晶体生产方法

3.2蓝宝石衬底材料市场分析

3.2.1全球市场现状

3.2.2中国市场现状

3.2.3中国市场格局

3.2.4技术发展分析

3.2.5发展困境分析

3.3蓝宝石项目生产状况

3.3.1原材料

3.3.2生产设备

3.3.3项目进展

3.4市场对蓝宝石衬底的需求分析

3.4.1民用半导体照明

3.4.2民用航空领域

3.4.3军工领域

3.4.4其他领域

3.5蓝宝石衬底材料的发展前景

3.5.1全球发展趋势

3.5.2未来市场需求

第四章 2017-2021年硅衬底发展分析

4.1半导体硅材料的基本情况

4.1.1电性能特点

4.1.2材料制备工艺

4.1.3材料加工过程

4.1.4主要性能参数

4.2硅衬底LED芯片主要制造工艺的综述

4.2.1 Si衬底LED芯片的制造

4.2.2 Si衬底LED封装的技术

4.2.3 S衬底LED芯片的测试结果

4.3硅衬底上GaN基LED的研究进展

4.3.1优缺点分析

4.3.2缓冲层技术

4.3.3 LED器件

4.4硅衬底材料技术发展

4.4.1国内技术现状

4.4.2中外技术差异

第五章 2017-2021年碳化硅衬底发展分析

5.1碳化硅衬底的基本情况

5.1.1性能及用途

5.1.2基础物理特征

5.2 SiC半导体材料研究的阐述

5.2.1 SiC半导体材料的结构

5.2.2 SiC半导体材料的性能

5.2.3 SiC半导体材料的制备

5.2.4 SiC半导体材料的应用

5.3 SiC单晶片CMP超精密加工的技术分析

5.3.1 CMP超精密加工发展

5.3.2 CMP技术的原理

5.3.3 CMP磨削材料去除速率

5.3.4 CMP磨削表面质量

5.3.5 CMP影响因素分析

5.3.6 CMP抛光的不足

5.3.7 CMP的发展趋势

5.4碳化硅衬底材料发展现状

5.4.1技术发展状况

5.4.2市场发展状况

第六章 2017-2021年砷化镓衬底发展分析

6.1砷化镓的基本情况

6.1.1定义及属性

6.1.2材料分类

6.2 砷化镓在光电子领域的应用

6.2.1 LED需求市场

6.2.2 LED应用状况

6.3 砷化镓衬底材料的发展

6.3.1 国外技术发展

6.3.2 国内技术发展

6.3.3 国内生产厂家

6.3.4 材料发展趋势

6.3.5 市场规模预测

第七章 2017-2021年其他衬底材料发展分析

7.1 氧化锌

7.1.1 氧化锌的定义

7.1.2 物理及化学性质

7.2 氮化镓

7.2.1 氮化镓的定义

7.2.2 GaN材料特性

7.2.3 GaN材料应用

7.2.4 技术研究进展

7.2.5 未来发展前景

第八章 LED用衬底材料行业重点企业分析

8.1 国外主要企业

8.1.1 京瓷 (Kyocera)

8.1.2 Namiki

8.1.3 Rubicon

8.1.4 Monocrystal

8.1.5 CREE

8.2 中国台湾主要企业

8.2.1 台湾中美硅晶制品股份有限公司

8.2.2 台湾合晶科技股份有限公司

8.2.3 台湾鑫晶钻科技股份有限公司

8.2.4 台湾晶美应用材料股份有限公司

8.2.5 台湾锐捷科技股份有限公司

8.3 中国大陆主要企业

8.3.1 天通控股股份有限公司

8.3.2 浙江水晶光电科技股份有限公司

8.3.3贵州皓天光电科技有限公司

8.3.4云南蓝晶科技有限公司

8.3.5青岛嘉星晶电科技股份有限公司

第九章 2022-2027年LED用衬底材料行业投资分析

9.1 LED照明行业投资时期「HJLT」

9.2中国LED市场发展前景

9.3全球市场发展规模预测

9.4 LED行业上游投资风险分析

图表目录：

图表LED应用领域细分情况

图表 中国LED显示屏应用产值

图表 中国LED背光源应用产值

图表 中国LED照明产品市场渗透率

图表2021年全球LED材料市场规模

图表 使用蓝宝石衬底做成的LED芯片示例

图表 蓝宝石生产线设备明细

图表 三种衬底性能比较

图表 晶格结构示意图

图表 晶向示意图

更多图表见正文……

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/electric/817859.html>